

中信证券股份有限公司
关于贵州振华风光半导体股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2026 年 4 月 17 日-18 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会、董事会议事规则等公司治理制度、股东会、董事会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2025 年度内部控制评价报告、2025 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

2025 年公司市场订单同比增长，但营业收入同比下滑，一方面，是受限于新产品尚未进入大规模量产阶段，规模效应未充分显现，另一方面，是高可靠领域产品验收周期较长及产品持续降价的影响。2026 年，公司将持续加大市场开拓和新产品研发，通过拓展新领域、开发新用户、快速推广新产品获取大量订单。若未来市场需求不及预期、行业竞争格局持续恶化、新产品研发进度于市场需求存在差异等，将可能导致公司当期的业绩下滑。

(二) 核心竞争力风险

1、研发未达预期风险

公司持续围绕市场需求开展核心技术研发、新产品拓展与技术升级，需投入大量资金与人力资源。由于高可靠集成电路验证流程复杂且技术成果产业化存在不确定性，叠加当前技术创新模式快速演进、性能及可靠性要求持续提升，若公

司研发进展不及预期或产品未能获得市场及客户认可，将面临研发投入难以回收、经营效益未达预期的风险，进而对公司核心竞争力与业绩产生不利影响。

2、研发人员不足或流失的风险

集成电路行业具有技术密集与人才密集特征，核心技术与高端人才是公司保持竞争优势的关键基础。当前行业技术创新难度持续提升，高端复合型人才竞争日趋激烈，对公司研发强度与人才梯队建设提出了更高要求。若公司盈利能力未能有效支撑持续的研发与人才投入，无法有效吸引、培养及保留核心技术人才，或出现研发人员流失情形，将可能导致公司核心竞争力下降。

（三）经营风险

1、客户集中度较高风险

报告期内，由于公司下游客户主要以央企及其下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户形成了密切配合的合作关系，按照特种元器件供应的体系，通常定型产品的供应商不会轻易更换，且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场，减少客户集中度高的潜在不利影响。但若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

（四）财务风险

1、应收账款及应收票据余额较高的风险

由于特种领域产品验收程序严格和复杂，同时受客户主要以商业票据结算为主的影响，导致公司应收账款、应收票据的规模较大。虽然公司客户主要为央企及其子公司，整体信誉较好，支付能力较强，但若公司不能有效提高应收票据及应收账款管理水平及保证回款进度，将有可能出现应收票据及应收账款持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司经营成果造成不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化应收账

款回款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

2、存货金额较大及发生减值风险

受产品种类型号多、验收程序繁琐等因素的影响，公司储备的原材料较大，客户尚未验收的发出商品余额较大，导致存货余额较高。同时，公司积极应对客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期客户的需求，对部分产品提前备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

风险管理措施：一方面公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制，同时加强销售队伍建设，不断完善客户需求分析管理体系，合理备货；另一方面严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

（五）行业风险

1、市场需求波动与竞争格局变化风险

当前半导体行业呈现结构性分化特征，AI 等领域需求强劲，成熟制程芯片同质化竞争激烈。高可靠集成电路领域虽进入壁垒较高，但仍受国防预算周期和装备采购节奏影响，若下游需求放缓或调整，将加剧市场竞争，对公司供应链稳定性和需求预测精度提出更高要求。

2、下游需求及产品销售价格波动风险

2025 年公司已面临特种集成电路产品持续降价压力，若未来市场需求波动或竞争加剧导致产品价格进一步下降，将对公司销售收入及毛利率造成持续不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	77,162.30	100,341.13	-23.10
利润总额	17,135.56	34,906.11	-50.91
归属于上市公司股东的净利润	17,004.08	28,770.02	-40.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,958.99	25,549.74	-41.45
经营活动产生的现金流量净额	55,236.79	-25,658.39	不适用
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	503,047.15	489,071.32	2.86
总资产	560,648.05	544,027.43	3.06
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.8502	1.4385	-40.90
稀释每股收益(元/股)	0.8502	1.4385	-40.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7479	1.2775	-41.46
加权平均净资产收益率(%)	3.43	5.99	减少2.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02	5.32	减少2.30个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.25	14.35	增加7.90个百分点

(1) 营业收入同比下降 23.10%，主要系报告期公司产品订货量同比增长，但受高可靠领域产品验收周期长和产品降价的影响，产品销售收入同比下降。

(2) 利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 50.91%、40.90%和 41.45%，主要原因：一是受高可靠领域产品降价及去库存行为的持续影响，营业收入和产品毛利率下降；二是为积极应对成熟型产品降价带来的影响，公司持续加大新产品和新工艺的研发力度，研发费用同比增加；三是本期货款收回同比大幅增加，期末应收款

项规模同比大幅下降，信用减值损失同比减少，增加利润约 1.01 亿元。但受公司主营业务毛利下降影响，公司整体利润总额同比有所下降。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 80,895.18 万元，主要系报告期内公司领导高度重视销售回款，采取一系列有效措施，取得回款大幅增加所致。

(4) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降 40.90%、40.90%和 41.46%，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。

(5) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别下降 2.56 个百分点、2.30 个百分点，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

(6) 研发投入占营业收入的比例同比增加 7.90 个百分点，主要系公司为了持续提升公司长效竞争力，更新关键技术和新产品研发的投入同比增加。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司的核心竞争力

1、研发方面

作为国内模拟集成电路产业的先驱企业，公司始终坚持市场需求与技术创新双轮驱动，持续加大研发投入，推动技术体系不断丰富升级。依托自主建设的集成电路研发设计平台。公司已在模拟、数模混合及系统集成领域形成深厚技术积累，产品谱系持续丰富，报告期内，公司成功中标 4 项国家重大项目。

在研发布局上，公司构建了贵阳、成都、西安、南京、上海五地协同的“多中心研发网络”，并与复旦大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学、贵州大学等高校，黑龙江省原子能研究院等科研院所深化产学研融合，通过共建联合实验室和专项合作，加速科技成果转化落地。同时，公司积极与成都、广州、上海、苏州、深圳、重庆等地的知名企业及科研机构开展技术协同创新，构建优势互补、资源共享的集成电路产业生态链。

在研发能力上，公司具备完整的集成电路前后端设计能力，工艺平台覆盖

Bipolar、CMOS、BiCMOS、BCD、抗辐照双极工艺、GaAs 等主流工艺，支持 4 μm 至 28nm 制程节点。依托自主开发的多模态器件模型库和多物理场设计仿真激励平台，实现极限工况下的精准设计，建成完善的放大器、专用转换器、接口驱动、电源管理器、RISC-V 架构 MCU 等信号链产品技术体系，以及信号调理、电机控制、射频微波等系统方案技术体系，可为用户提供定制化的模拟信号链全域解决方案，具备从芯片设计、器件仿真、封装测试、应用验证到算法建模的全流程自主研发能力。

在研发平台上，公司建成超大规模异地协同计算集群，支持模拟、数模混合及数字集成电路全流程仿真验证，具备海量迭代数据存储与并行计算任务调度能力，可满足 600 人级并发在线协同设计需求。

2、制造能力方面

公司已构建覆盖厚膜陶瓷基板、气密性封装、塑封器件及 SMT 贴片的规模化制造能力，可提供从晶圆进料到成品交付的全流程封装解决方案。在设计与仿真层面，具备电性能、热管理、结构优化及可制造性分析能力，支持 6 吋至 12 吋晶圆加工服务。封装形式涵盖 CDIP/CLCC/CBGA 等多品种陶瓷封装、金属腔体/圆柱/法兰等多类型金属封装、SOP/SOT/QFP/BGA 等高可靠塑封，以及 FCBGA/BGA/SiP 等系统级封装。产品可靠性满足 B/H 级至 S 级/K/N1 级等严格等级要求，并可依据客户需求提供高频、高导热等场景下的定制化封装服务。

3、测试能力方面

振华风光构建了覆盖测试、应用验证、激光修调及失效分析的全方位测试技术体系。在模拟与混合信号测试领域，攻克了旋变解码器全参数自动化测试及高压差分放大器共模电压 400V 理论提升等关键技术，开发了 32 位 MCU 全维度自动化测试平台，核心代码复用率超 60%，并将射频测试频段拓展至 6GHz。应用验证方面，突破 20V_{pp}/100MHz 功率噪声合成及 4500V/us 高压摆率信号源生成技术，研制的 16 通道板级测试系统预计提升效率 20 倍以上。激光修调实现 $\pm 420\text{V}$ 高压晶圆自动测试与 μA 级电流精准测量，完成 J750 与 UF2000 平台互联。失效分析领域自主研发通用运放 SPICE 模型，建模效率提升一倍，FIB 电路编辑超 80 项，外观检测通过 5T 图像数据库实现效率提升 70%以上，一次校验合格

率达 99%，形成了从晶圆级测试到系统级验证、从物理分析到仿真建模的自主掌握技术体系。

4、质量管理能力方面

公司坚守既定质量方针，构建覆盖产品全生命周期的质量管理体系，持续打造高可靠产品优势。以 GJB9001C 体系为基石完成 8 个类别产品科研生产扩项，涵盖单片驱动器、电源管理电路、数据转换器、存储器、微处理器等高可靠元器件领域，先后通过 IATF16949 车规、GJB7400 塑封贯标、AS9100D 民用航空航天三大认证，分别夯实车规产品质量、塑封封装能力并为航空市场拓展奠定基础；通过新时代质量管理体系三级评价，同步推进数字化转型与全产业链质量协同。

报告期内，公司质量提升成效显著，获得全国优秀 QC 成果一等奖 1 项，获得贵州省优秀 QC 成果特级 3 项、一级 3 项，获得贵州省全面质量管理优秀企业、制造企业质量管理能力评估“保证级”。

5、市场方面

近年来，公司加大研发平台建设及新品经费投入，全力打造信号链、电源、射频微波、抗辐照及数字信号处理等产品，持续完善从芯片设计到系统集成的完整技术体系。在产品体系中，重点突破信号调理、低噪声放大、高精度模数转换、电机驱动等关键技术，推出覆盖高可靠、商业航天、无人机领域、医疗电子、电网控制等多场景应用的产品系列；

报告期内，公司加快民品市场拓展与国际化业务布局进程：民品方面，在商业航天、小卫星、无人机、商业大飞机等高可靠领域取得订货突破。上述多元化市场布局，为公司未来市场增量奠定坚实基础。报告期内，公司获得 3 家用户授予的“金牌供应商”称号。

6、人才方面

公司始终坚持人才引领发展战略，持续完善人才选拔、培养、激励与发展机制，不断夯实高质量发展的人才基础。报告期内，公司人员结构持续优化，员工总数达到 855 人（含环宇芯），科研技术人员占比提升 3%，全年共引进专业技术人才 48 人，来自清华大学、复旦大学等国内顶尖高校的人才共 3 人，其中硕

博学历占比 52.01%。同时，通过系统化培训、岗位历练、项目赋能等多元化方式，全面提升员工专业素养与综合能力，着力构建结构合理、素质优良、富有活力的人才梯队。

7、企业文化

公司围绕“拼搏奉献、担当务实、创新发展、卓越共赢”的核心价值观，以党建为引领深化企业文化建设，将“科技为先、质量为本、用户至上、诚信共赢”的经营理念融入员工日常实践。公司始终坚持以人为本，视员工为企业最宝贵的资源，通过开展多元主题活动、常态化为职工办实事、完善园区配套设施、打造多维宣教阵地，持续激发员工活力、凝聚团队合力，致力于实现“百年风光梦，幸福风光人”的企业愿景，推动员工价值实现与企业高质量发展同频共振。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	17,165.30	14,395.62	19.24
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	17,165.30	14,395.62	19.24
研发投入总额占营业收入比例（%）	22.25	14.35	增加 7.90 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2025 年度，公司研发投入总额占营业收入的比例为 22.25%，同比增加 7.90 个百分点，研发投入总额较上年同期未发生重大变化。

（二）研发进展

报告期内，公司有 1 项技术成果高压低功耗、高速宽带放大器，通过中国电子信息产业集团有限公司组织的成果鉴定，鉴定成果为国内领先。

高压低功耗、高速宽带放大器在大摆率低失真、低偏置电流高阻抗设计技术、电流正反馈技术及输入级电路线性度提升等设计技术上进行设计创新，申请发明专利 5 件，授权 2 件，集成电路布图设计登记 7 件。获 1 项科技成果鉴定，技术水平达国内领先。

报告期内，公司在集成电路设计领域，申请发明专利 48 件、实用新型专利 2 件、集成电路布图设计 86 件，软件著作权 1 件；在集成电路封测领域，申请发明专利 13 件、软件著作权 4 件。目前已形成 400 余款产品，服务于 800 余家用户单位，广泛应用于高可靠领域。

报告期内，公司获得了 1 项贵州省第十届专利优秀奖；贵州省优秀博士站；通过贵州省 2025 年企业研发创新扶持及科技型“三上”企业培育认定；入选 2025 年贵州省制造业中试平台。

报告期内获得的知识产权列表：

类型	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	61	18	200	64
实用新型专利	2	2	91	88
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	5	5	12	12
其他	86	83	304	298
合计	154	108	607	462

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告

和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度相比原计划有所延后，公司已审议通过募投项目延期的议案，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有公司 40.12%的股份。公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其通过持有中国电子有限公司与中国振华股权间接控制振华风光 40.12%的股份，并通过中电金投间接控制振华风光 2.92%的股份，合计控制振华风光 43.04%的股份。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股票，通过员工持股平台贵州风光智管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风光智”）及贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风光芯”）间接持有公司股票情况如下：

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	质押或冻结情况
1	朱枝勇	董事长	无	无质押或冻结
2	赵晓辉	副董事长	通过风光智间接持有公司 0.074%的股份	无质押或冻结
3	胡锐	董事、总经理、核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.050%的股份	无质押或冻结
4	刘宗永	总法律顾问	通过风光芯间接持有公司 0.048%的股份	无质押或冻结
5	刘岗岗	副总经理	通过风光芯间接持有公司 0.048%的股份	无质押或冻结

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	质押或冻结情况
6	唐拓	副总经理	通过风光智间接持有公司 0.048%的股份	无质押或冻结
7	段方	副总经理	通过风光智间接持有公司 0.033%的股份	无质押或冻结
8	刘健	副总经理	通过风光芯间接持有公司 0.048%的股份	无质押或冻结
9	张博学	董事会秘书、 总会计师	通过风光芯间接持有公司 0.015%的股份	无质押或冻结
10	李政	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.022%的股份	无质押或冻结
11	李平	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.017%的股份	无质押或冻结
12	唐毓尚	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.032%的股份	无质押或冻结
13	夏良	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.011%的股份	无质押或冻结
14	李雪	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.011%的股份	无质押或冻结

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

经公司自查发现，公司于 2025 年 1 月收到客户 A 退货，由于客户退货事项存在不确定性，导致内部判断错误，使得上述退货未作为 2024 年度期后调整事项进行账务处理。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，公司对前期会计差错进行更正。保荐人提请公司加强内部控制管理，规范财务核算，提高信息披露质量，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务，维护公司及广大投资者的利益。

2025 年度，受高可靠领域产品验收周期长和产品降价的影响，公司产品销售收入同比下降。受公司主营业务毛利下降影响，公司整体利润总额同比有所下降。保荐人提请公司注意从政策层面、行业发展层面及公司自身经营层面分析业绩下滑的原因，并制定有针对性的措施，积极改善经营业绩，为广大投资者持续创造价值。

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



马峥



石家峥

